

<<精密加工实用技术>>

图书基本信息

书名：<<精密加工实用技术>>

13位ISBN编号：9787111187110

10位ISBN编号：7111187113

出版时间：2006-4

出版时间：机械工业出版社

作者：杨江河

页数：226

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<精密加工实用技术>>

内容概要

精密加工技术是先进制造技术的基础和关键，是先进和实用的技术。本书内容主要包括精密加工概述、精密切削加工、精密磨削加工、精密特种加工技术、金属精密加工应用实例、硬脆非金属材料精密加工实例和半导体基片的超精密加工等。本书适合从事精密加工的技术工人使用，也可供从事精密加工的工程技术人员及管理人员参考。

<<精密加工实用技术>>

书籍目录

前言第一章 精密加工概述第一节 精密加工的技术内涵一、精密加工的范畴二、精密加工的特点三、精密加工方法及其分类第二节 精密加工体系及发展一、精密加工的体系结构二、精密加工关键技术三、精密加工的形成和发展第二章 精密切削加工第一节 精密切削机理一、精密切削加工简介二、精密切削加工机理第二节 精密切削加工机床及其应用一、精密机床发展概况二、精密切削机床主要部件三、典型精密和超精密机床简介第三章 精密磨削加工第一节 精密磨削加工机理一、磨削技术发展概述二、精密磨削加工机理三、精密磨削加工机床及其应用第二节 超精密磨削加工技术一、超精密磨削机理二、研磨技术第四章 精密特种加工技术简介第一节 概述一、特种加工方法的种类二、特种加工的特点第二节 典型的精密特种加工技术一、电火花加工二、电解加工三、高能束加工四、超声加工第五章 金属精密加工工艺及实例第一节 精密加工与热处理一、精密加工和热处理二、热处理和淬火变形三、精密零件的热处理四、精密加工后的零件热处理五、热处理后尚需进行精密加工的零件六、精密热处理七、结束语第二节 超精密切削加工工艺及实例一、超精加工工艺二、金刚石刀具超精密车削的应用及其发展三、超声振动加工实例四、特种珩磨工艺实例五、研磨加工实例第三节 特种加工工艺应用实例一、挤压珩磨加工实例二、光化学加工实例三、高能束加工实例四、电解加工实例五、电火花加工实例六、磨粒流工艺应用实例第四节 金属超精密加工实例一、球面、非球面反射镜的精密切削二、多面反射镜的精密切削三、硬磁盘基片的精密切削四、模具的研磨、抛光第五节 典型精密元件加工一、精密平板和90°角尺加工二、精密分度板(盘)加工三、精密球体加工第六章 硬脆非金属材料的精密加工实例第一节 陶瓷加工一、陶瓷的种类和性质二、陶瓷的研磨三、陶瓷的抛光第二节 磁头的精密加工一、薄膜型磁头的超精密加工二、加工方法和加工系统三、V1R用磁头的超精密加工第三节 光学透镜、棱镜的加工一、概述二、影响光学元件加工精度的因素三、非球面透镜的超精密加工第四节 反射光栅的加工第五节 石英振子的加工第六节 金刚石的超精密加工一、金刚石的特性二、金刚石戒面(钻石戒面)的加工三、金刚石刀具的加工四、生物显微组织切片刀的加工五、硬度计用金刚石压头的加工第七节 宝石的加工一、概述二、宝石加工用的磨料、磨具三、宝石的切割四、素面宝石加工五、刻面宝石加工六、圆珠及圆球的加工七、宝石孔的加工第七章 半导体基片的超精密加工第一节 半导体基片的加工特性一、概述二、基片的规格和有关问题三、单晶的特性及基片的加工工序第二节 半导体基片的加工技术一、切片和集成块分离切断二、磨削与倒角三、基片的研磨四、基片的腐蚀五、基片的机械化学抛光第三节 其他加工方法和加工装置一、蓝宝石基片的加工二、磷化铟(InP)基片的加工第四节 半导体基片加工的外围技术一、基片的检测二、基片的清洗技术三、基片的粘接及无蜡抛光四、精密和超精密加工的环境设施参考文献

<<精密加工实用技术>>

编辑推荐

《精密加工实用技术》内容主要包括精密加工概述、精密切削加工、精密磨削加工、精密特种加工技术、金属精密加工应用实例、硬脆非金属材料精密加工实例和半导体基片的超精密加工等。本书适合从事精密加工的技术工人使用，也可供从事精密加工的工程技术人员及管理人员参考。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>